

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-016

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信建投、嘉实基金、平安养老、长江证券、淡水泉。
会议时间	2023年12月13日-2023年12月14日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、公司前 3 个季度经营性现金流净额为什么为负？</p> <p>答复：主要原因在于归还客户前期缴付的产能保证金。</p> <p>问题 2、研发团队的情况？</p> <p>答复：公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，拥有在行业内多年的技术研发经验。公司持续进行研发团队的建设与研发能力的提升，目前研发技术人员大概占员工总数比例为 1/3 左右。</p> <p>问题 3、公司竞争优势是什么？</p> <p>答复：（1）地域优势。晶合选址合肥，初期便以 DDIC 为切入点，合肥在显示领域产业链配套齐全，从</p>

	<p>而大幅降低了物流和时间成本。同时公司作为集成电路产业发展中的重要一环，受到地方政府的大力支持。</p> <p>(2) 客户关系紧密。公司目前在 DDIC 领域的市占率较高，能为客户提供多工艺平台的支撑。另外晶合与部分客户保持战略合作，结合客户的需求持续推进新产品的开发。(3) 公司的研发团队稳定，核心凝聚力较强，并且具有丰富的技术经验。(4) 前瞻性产能布局。公司根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划，及时满足市场需求。</p> <p>问题 4、介绍一下车用芯片的研发进展？</p> <p>答复：公司 110 纳米 DDIC 已于 2023 年 3 月完成 AEC-Q100 车规级认证，于 2023 年 5 月已通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试，其他几个工艺平台正在验证中。未来将持续推进微控制器、电源管理以及图像传感器芯片的认证，全面进入汽车电子芯片市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 15 日